

HNO₃ 전해액이 Cu 표면에 미치는 영향

박성우 , 한상준, 이영균, 이우선, 서용진*
조선대학교 전기공학과, 대불대학교 전기공학과*

Effect of copper surface to HNO₃ electrolyte

Sung-Woo Park, Sang-Jun Han, Young-Kyun Lee, Woo-Sun Lee and Yong-Jin Seo*

Department of Electrical Engineering, Chosun University, Department of Electrical Engineering, Daebul University.*

Abstract : 본 논문에서는 Cu의 ECMP 적용을 위해 HNO₃ 전해액의 active, passive, transient, trans-passive 영역을 I-V 특성 곡선을 통해 알아보았고, LSV (Linear sweep voltammetry)와 CV (Cyclic voltammetry)법을 통하여 전기화학적 특성을 비교 분석하였다.

Key Words : Electrochemical Mechanical Polishing (ECMP), HNO₃, Linear sweep voltammetry (LSV), Cyclic voltammetry (CV)